

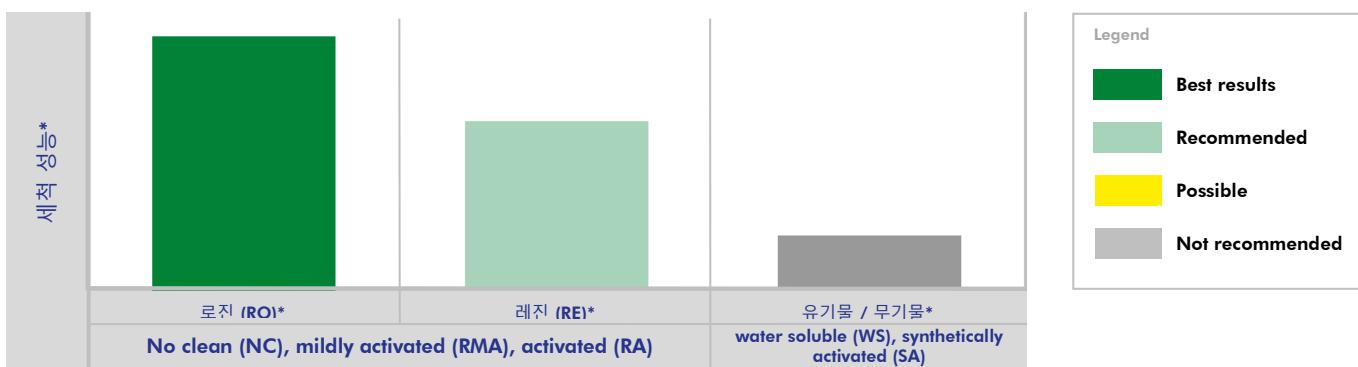
VIGON® EFM

Rework 이후 PCBA 매뉴얼 세척을 위해 만들어진 솔벤트 기반 플럭스 세척제



VIGON® EFM은 전자어셈블리를 매뉴얼로 세척할 경우 플럭스 잔여물을 제거하도록 만들어진 정밀 세척제입니다. 이 제품은 방폭 스프레이 탑재 장비에서도 사용할 수 있습니다. VIGON® EFM은 할로겐 화합물을 포함하지 않은 유기용제의 혼합물이기 때문에 빠르게 건조되고 잔여물을 남기지 않습니다. 또한 부식이 되지 않으며 대부분의 폴리머와 호환 가능합니다.

적용 범위 – PCBA 디플럭싱



* J-STD-004

다른 세척제와 비교 시 이점

- 특히 레진 기반의 플럭스 잔여물을 제거에 적합합니다.
- 용액이 매우 빠르게 건조되고 잔사가 남지 않습니다.
- 폭발 방지 장치에서 매뉴얼 및 자동 세척 시스템 모두에 사용하기 쉽습니다.
- 세척제 및 행굼제로 매우 적합한 용액입니다.

공정 단계

세척 공정	부품	1. 세척	2. 린스	3. 건조
매뉴얼 세척	PCBAs	VIGON® EFM	VIGON® EFM	Compressed air or open air evaporation
Spray-in-air (폭발 방지)	PCBAs	VIGON® EFM	VIGON® EFM	Compressed air or open air evaporation